



ROHDE & SCHWARZ

ローデ・シュワルツ主催 EMCユーザ会議2017のご案内 2017年 5月 11日(木)開催



お申込みは下記 **Webサイト** または担当営業まで
http://www.rohde-schwarz.co.jp/events/seminars/RSJP201705_emc-u.html

I はじめに

毎年の恒例行事となりました、EMCユーザ会議を開催致します。本ユーザ会議を通じて、EMCに関わる皆様と技術情報を共有する機会を設けることで、業務改善に少しでも貢献できればと考えております。また、セミナー終了後には講師を交えた無料懇親会も予定しておりますので、是非ともご来場いただければと存じます。

会 場

東京コンファレンスセンター・品川
大ホール (5F)
〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 3F-5F
TEL : 03-6717-7000 / FAX : 03-6717-7001

日 時

2017年5月11日(木) 12:00 ~ 受付開始
13:00 ~ セミナ開始

対 象

EMC評価および対策を行われているエンジニアの方を対象としております。

定 員

基調講演 : 350名

受講料

セミナーおよび懇親会、共に無料となります。

お申込締切日

2017年5月8日(月)

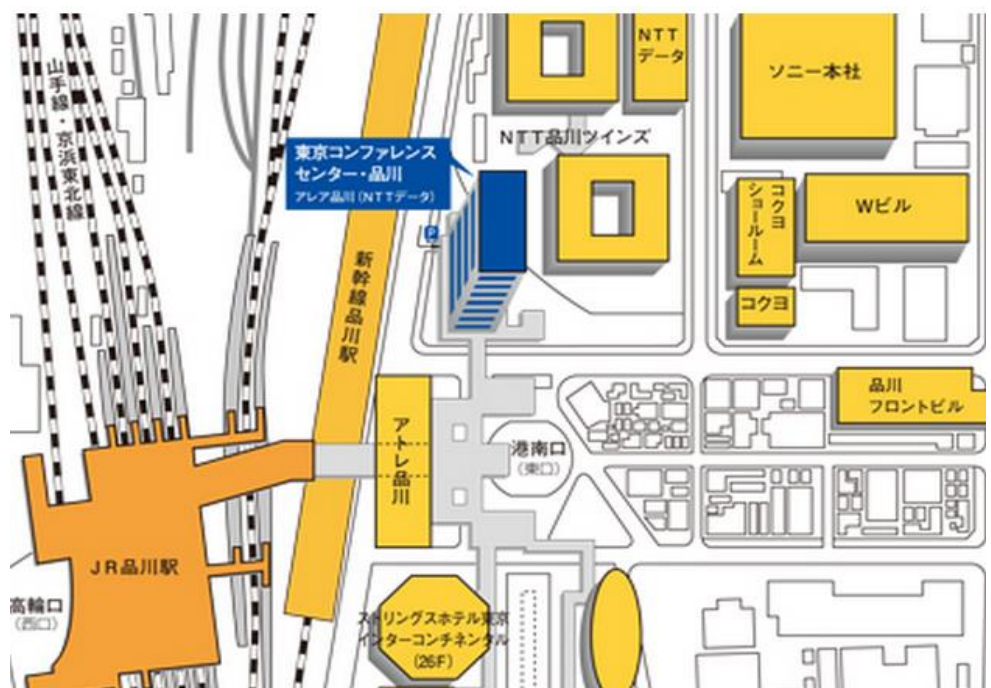
お問合わせ先

セミナー事務局 TEL : 03-5925-1270
Email: info.rsjp@rohde-schwarz.com

会場アクセス

JR品川駅港南口(東口)より徒歩2分

アクセスマップ



時間	内容	
13:00	開会のご挨拶	
13:05 ~ 13:45	基調講演 「パワーエレクトロニクスの進化に直面するEMC」 大阪大学大学院 教授 舟木 剛氏 省エネの手段として不可欠なパワーエレクトロニクスにおいて、SiCやGaNといった新材料を用いたパワーデバイスが注目されている。これらのパワーデバイスを用いることで、パワーエレクトロニクス回路において、高電圧や大電流の高速スイッチング動作が可能となる。一方でこれはdv/dtやdi/dtが大きくなることを意味し、大きなノイズ源となり得るため、回路やシステムにおけるEMCの設計が一層重要となってくる。本講演では、SiC、GaNパワーデバイスのスイッチング動作にともなうEMCの現象について、実測例を交えて紹介するとともに課題について述べる。	
13:45 ~ 14:25	技術講演1 「EMC規格の最新動向」 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Mr. Matthias Keller (逐次通訳) EMC規格への準拠は、電子設計で作業するすべてのエンジニアに関わるトピックです。厳しいEMC規格へ準拠するために、製品認証が遅れ、収益の損失、コストの増加、そして再設計にまで至ってしまうケースがあります。本セミナーでは、CISPRの最新情報を提供し、最新のEMIテスト手順と機器のイノベーションについてご紹介いたします。	
14:25 ~ 15:00	技術講演2 「CISPR35の情報アップデート」 Rohde & Schwarz Asia Pte. Ltd. Mr. AnnTat Kuah (逐次通訳) CISPR 35は、IT製品のイミュニティ規格である。本セミナーでは、この規格に準拠した試験方法や、測定におけるキーポイントについて解説する。また、必要な計測器やアクセサリ等についても取り上げる予定である。	
15:00	休憩 (30分間) 弊社および協賛メーカー様による製品展示等も行ってまいりますので是非ご覧ください。	
	セミナーA(自動車関連)	セミナーB(民生関連)
15:30 ~ 16:20	技術講演A-1「調整中」 日産自動車(株) 電子技術・システム技術開発本部 電子アーキテクチャ開発部 電子信頼性評価グループ 主査 塚原 仁氏 調整中	技術講演B-1「CISPR 32/35における有線ネットワークポートの許容値と測定法について - 検討経緯と規格化の根拠ならびに今後の課題 - 」 電気通信大学 産学官連携センター 客員教授 CISPR/I Technical Secretary 雨宮 不二雄氏
16:20 ~ 17:10	技術講演A-2「自動車・車載部品の国際規格概要と試験動向のポイント」 (株)ノイズ研究所 技術部 上席部長 石田 武志氏 自動車は、安全を第一に厳しいEMC試験を実施し、その試験方法は、国際規格ISO、CISPRで定められ、また型式認証基準として国連の下位組織である国連欧州経済委員会で施行するECE-R10によって世界的な基準ができてきた。そこには家庭内で充電を必要とするEV・HEVに対する対応も取り込まれ、従来関連がなかったIEC規格が自動車の試験に必要となっている。この様に、自動車の進化に対応し、試験規格も追従しているが、更に高度な技術を取り込む自動車に対して未だ確立されていない部分もある。現状の規格を理解した上で課題を整理し、今後注目すべき点を説明する。	技術講演B-2「ノイズの発生と結合のメカニズムに基づくEMC設計・対策技術」 (株)トーキンEMCエンジニアリング EMCテクニカルセンター 技術長 工学博士 原田 高志氏 エレクトロニクス機器のEMC設計・対策は「ノイズ」と言う非意図的に発生、結合する現象を扱うことから、かつては、Rule of thumbとも呼ばれ、もっぱら熟練した技術者の勘と経験に頼っていた。しかし、国内外の多くの研究者、技術者によりEMCで問題となるノイズの発生と結合のメカニズムが物理的に解明され、それぞれの理屈に基づき設計・対策技術が確立、体系化されるに至っている。本講演ではデジタル信号処理や電力制御などの機器を構成するプリント回路基板や配線のレベルを対象として、これまで明らかにされてきた回路動作とノイズ発生の関係や、発生したノイズの伝搬や放射などの電磁学的な振る舞いを総括し、それぞれのメカニズムに基づいたEMC設計・対策手法を理論的に説明する。
17:10 ~ 18:00	技術講演A-3「車載電子システムにおけるEMC対応設計のポイント」 (株)クオルテック EMC技術研究室 室長 工学博士 前野 剛氏 近年の自動車の趨勢は自動運転化であるが、これに伴って高電圧・大電流化や機器の高速処理化によるノイズ発生源の増加や、受信機能やセンサ等のノイズに敏感な機器の増加で、自動車のEMC問題の要因はこれまで以上に増加すると考えられる。このような電磁環境に対応するためには輻射や流入ノイズの少ない電子機器を設計することが重要であり、そのためには回路基板のグラウンドを含むパターン設計が重要であるが、グラウンドパターンの接地処理が不適切だと電子機器単体ではEMC性能が良くてもシステム化すると良くないという結果にもなる。また電磁シールドやデバイスの放熱処理についての不適切な応用事例も散見される。ここでは、これらについての対策事例などを紹介すると共に、その物理的な考察も加える。	技術講演B-3「EMC設計プロセスのポイントと事例の紹介」 パナソニック(株)プロダクト解析センター 電気ソリューション部 電子回路設計課 大住 秀夫氏 「前回と同じように設計したのに、何故、今回はEMCの課題が多いの？」こんな悩みをお持ちではありませんか？ EMCの原理・原則は、数多くあるが、全ての商品に適用できるEMC設計ルールは存在しない。実際の商品開発の過程においては、「商品毎にEMC設計ルールを作る」というスタンスを取ることが最も合理的であるといえる。そして、そのためには衆知でアイデアを生み出し、検証を経て設計仕様化し、確実に商品設計に反映させてゆくことが必要となる。 本講義では、 ・「EMC設計プロセス」の5つのメリット ・具体商品の「EMC設計事例」 を通じ、EMC設計の重要性とEMC設計の原理・原則を紹介する。
18:15	質疑応答	
~ 20:00	懇親会 (参加費無料) : 軽食とお飲み物をご用意しておりますので、是非お気軽にご参加下さい。	